

Regime de Origem do Acordo Mercosul-Chile

APÊNDICE 4 DO ANEXO 13 DO ACE - 35

REGIME DE ORIGEM PARA O SETOR DE INFORMÁTICA E DE TELECOMUNICAÇÕES

SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES

NALADISA	DESCRIÇÃO	REQUISITO
85.17	<p>Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fio, incluídos os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora</p> <p>Exceto os seguintes produtos:</p> <p>do código 8517.40.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aparelhos de fac-símile -Equipamentos terminais ou repetidores sobre linhas de fibras ópticas, com capacidade de transmissão superior a 140Mbits/s. -Multiplexadores por divisão de tempo, digitais síncronos, com capacidade de transmissão igual ou superior a 155Mbits/s. <p>do código 8517.81.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aparelho de gerenciamento de redes ("TMN - Telecommunications Management Network") 	<p>Devem cumprir com o requisito de origem previsto no Artigo 3º, inciso "6" e o seguinte processo produtivo: montagem de no mínimo 80% das placas de circuito impresso, por produto; montagem e solda de todos os componentes na placa de circuito impresso; das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes e integração das placas de circuito impresso e nas partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.</p>

NALADI/SH	DESCRIÇÃO	REQUISITOS
85.25	<p>Aparelhos transmissores (emissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som, câmaras de televisão</p> <p>Exceto os seguintes produtos:</p> <p>do código 8525.20.00:</p> <p>-De telecomunicação por satélite:</p> <p>--Para estação principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor.</p> <p>--Para estações VSAT ("Very Small Aperture Terminal"), sem conjunto antena-refletor.</p> <p>-De telefonia celular:</p> <p>--Para estação base:</p> <p>--Terminais fixos, sem fonte própria de energia.</p> <p>-Do tipo modulador-demodulador ("rádio modem").</p>	Idem
8527.90.00	Exclusivamente receptores pessoais de radiomensagens de frequência inferior a 150MHz.	Idem
8529.90.00	Exclusivamente de aparelhos das subposições 8525.10 e 8525.20, exceto gabinetes e bastidores.	Idem
8543.80.00	<p>Exceto os seguintes produtos:</p> <p>-Amplificadores de radiofrequência:</p> <p>--Para transmissão de sinais de microondas de alta potência (HPA), a válvula TWT do tipo "Phase Combiner", com potência de saída superior a 2,7kW</p> <p>--Para distribuição de sinais de televisão</p> <p>-Aparelhos para eletrocutar insetos</p>	Idem

SETOR DE INFORMÁTICA

01 - Básico

NALADI/SH	DESCRIÇÃO
8470.50.00	Exclusivamente eletrônicas
8471.20.00	Exclusivamente os seguintes produtos: -De peso superior a 10kg ou que funcionem somente com fonte externa de energia. -De peso inferior a 2,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com um visor ("Display") de área superior a 140cm ² e inferior a 560cm ² , capazes de funcionar sem fonte externa de energia.
8471.91.00	Exceto as seguintes unidades digitais de processamento: - De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.93, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US\$ 12.500,00, por unidade. - De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.92, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.93, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB superior a US\$ 12.500,00 e inferior ou igual a US\$ 46.000,00, por unidade. - De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.92, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.93, e valor FOB superior a US\$ 46.000,00 e inferior ou igual a US\$ 100.000,00, por unidade. - De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.92, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.93, e valor FOB superior a US\$ 100.000,00, por unidade.

NALADI/SH	DESCRIÇÃO
8471.92.00	<p>Exceto os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Impressoras que não sejam de impacto: <ul style="list-style-type: none"> --De transferência térmica, policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 3 páginas por minuto, com largura de impressão inferior ou igual a 580mm. --Com largura de impressão superior a 580mm e velocidade de impressão inferior ou igual a 50 páginas por minuto. --A “laser”, com resolução igual ou superior a 800 pontos/polegada, largura de impressão igual ou superior a 297mm (A3) e velocidade de impressão de pelo menos 6 ppm (páginas por minuto) mas inferior ou igual a 50 ppm. --Policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 3ppm (páginas por minuto) e capacidade de combinar no mínimo 16 milhões de cores, exceto as de jato de tinta. --Com velocidade de impressão superior a 50 páginas por minuto. -Traçadores gráficos (“plotters”), com largura de impressão superior a 580mm, que não imprimam por meio de penas. -Digitalizadores de imagens. -Mesas digitalizadoras. -Impressoras de código de barras postais, tipo 3 em 5, a jato de tinta fluorescente, com velocidade de até 4,5 metros por segundo e passo de 1,4mm.
8471.93.00	<p>Exceto os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Unidades de discos magnéticos. -Unidades para discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico). -Unidades de fitas magnéticas para cartuchos e cassetes.

NALADI/SH	DESCRIÇÃO
8471.99.00	<p>Exceto os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Controladora de comunicações (“front-end processor”). -Distribuidor de conexões para redes (“hub”).
8472.90.00	<p>Exclusivamente os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Distribuidores (dispensadores) automáticos de papel-moeda, incluídos os que efetuam outras operações bancárias. -Máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco, com dispositivo para autenticar. -Classificadoras automáticas de documentos, com leitores ou gravadores da subposição 8471.99 incorporados, com capacidade de classificação inferior ou igual a 400 documentos por minuto.
8473.29.00	<p>Exclusivamente partes de caixas registradoras da subposição 8470.50 (exceto circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados) e partes de máquinas da subposição 8470.90.</p>
8473.30.00	<p>Exceto os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mecanismos completos de impressoras a "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), montados. -Martelo de impressão e bancos de martelos. -Cabeças de impressão, térmicas. -Cintas de caracteres. -Braços posicionadores de cabeças magnéticas e cabeças magnéticas de unidades de discos magnéticos ou de fitas magnéticas. -Mecanismo bobinador para unidades de fitas magnéticas (“Magnetic Tape Transport”). -Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados. -Cartões de memória (“Memory Card”). -Telas (“Display”) para microcomputadores portáteis.

NALADI/SH	DESCRIÇÃO
8473.40.00	<p>EXCETO os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados. -De distribuidores (dispensadores) automáticos de papel moeda, incluídos os que efetuam outras operações bancárias. -De máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco, com dispositivo para autenticar.
8511.80.00	Exclusivamente ignição eletrônica digital.
8517.40.00	Exclusivamente aparelhos de fac-símile.
8531.20.00	Todos os produtos.
8537.10.00	Exclusivamente comando numérico computadorizado - CNC.
8540.30.00	Exclusivamente tubos catódicos de unidades de saída por vídeo ("monitores") da subposição 8471.92, monocromáticos, com diagonal de tela superior ou igual a 35,56cm (14 polegadas).
9026.10.00	Exclusivamente medidores-transmissores eletrônicos para medida ou controle de vazão, que funcionem pelo princípio de indução eletromagnética.
9028.30.00	Exclusivamente monofásicos, para corrente alternada, bifásicos e trifásicos, digitais.
9030.39.00	Exclusivamente voltímetros.
9030.40.00	Todos os produtos.
9030.81.00	<p>Exclusivamente os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -De teste de circuitos integrados. -De teste de continuidade de circuitos impressos.
9030.89.00	<p>Exceto os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analisador lógico de circuitos digitais. -Analisador de espectro de frequência.
9030.90.00	Exceto instrumentos e aparelhos da subposição 9030.10.
9031.80.00	Exclusivamente aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computadores de bordo).
9032.89.00	<p>Exclusivamente os seguintes produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reguladores de voltagem eletrônicos. -Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados em veículos automóveis. -Outros instrumentos e aparelhos para regulação e controle de grandezas não elétricas.

A - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso.

B - Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes.

C - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" acima.

Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:

1) Mecanismos completos de impressoras a "laser", "LED" (diodos emissores de luz) ou "LCS" (sistema de cristal líquido), montados (código 8473.30.00), para impressoras do código 8471.92.00, com largura de impressão inferior ou igual a 580mm.

2) Mecanismos de impressão com sistema térmico ou a "laser" (código 8517.90.00), para aparelhos de fac-símile, do código 8517.40.00.

3) Banco de martelos (código 8473.30.00) para impressoras de impacto que operem linha a linha (código 8471.92.00).

Será admitida a utilização de subconjuntos montados nos Países signatários, por terceiros fabricantes, desde que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A" e "B".

Não descaracteriza o atendimento ao Regime de Origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.

02 - Microcomputadores portáteis de peso inferior ou igual a 10Kg, capazes de funcionar sem fonte externa de energia (código 8471.20.00), exceto os seguintes produtos:

--De peso inferior a 750g, sem teclado incorporado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e de comandos através de um visor ("Display") de área inferior a 280cm² (PDA - "Personal Digital Assistant").

--De peso inferior a 350g, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com um visor ("Display") de área inferior a 140 cm² ("Palmtop").

A - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementam as funções de processamento e memória, as controladoras de periféricos para teclado, vídeo e unidades de discos magnéticos rígidos e as interfaces de comunicação serial e paralela cumulativamente.

Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso que implementem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso.

B - Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas em nível básico de componentes.

C - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" acima.

Ficam dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:

-Visor ("display") (código 8473.30.00) para microcomputadores portáteis.

A inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação, não descaracteriza o atendimento ao Regime de Origem definido.

03 - Unidades digitais de processamento de computadores de pequena capacidade (código 8471.91.00), baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação dentro do mesmo gabinete de unidades de memória da subposição 8471.93, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou igual a US\$ 12.500,00, por unidade.

A - Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementam as funções de processamento e memória e as seguintes interfaces: serial, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado e de vídeo, cumulativamente.

Quando as unidades centrais de processamento incorporarem no mesmo corpo ou gabinete placas de circuito impresso que implementarem as funções de rede local ou emulação de terminal, estas placas também deverão ter a montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso.

Nas unidades digitais de processamento do tipo "diskless", destinadas à interconexão em redes locais, a montagem da placa que implementa a interface de rede local poderá substituir a montagem das placas que implementam as interfaces serial, paralela e de unidades de discos magnéticos.

B - Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas em nível básico de componentes.

C - Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" acima.

Não descaracteriza o atendimento ao Regime de Origem definido, a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação.

04 - Exclusivamente as seguintes unidades digitais de computadores de média e grande capacidade (código 8471.91.00):

- De computadores de média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.92, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.93, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor FOB superior a US\$ 12.500,00 e inferior ou igual a US\$ 46.000,00, por unidade
- De computadores de grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.92, com capacidade de instalação interna ou em módulos separados do gabinete do processador central de unidades de memória da subposição 8471.93, e valor FOB superior a US\$ 46.000,00 e inferior ou igual a US\$ 100.000,00, por unidade

A - Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem, no mínimo, 3 (três) das 5 (cinco) seguintes funções: a) processamento central; b) memória; c) unidade de controle integrada/interface ou controladoras de periféricos; d) suporte e diagnóstico de sistema; e) canal ou interface de comunicação com unidade de entrada e saída de dados e periféricos; ou, alternativamente, a montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito impresso que implementem quaisquer destas funções.

B - Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final.

C - Quando a montagem do produto for realizada com conjuntos em forma de gaveta, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fonte de alimentação, placa de circuito impresso e cabos.

Quando a empresa optar pela montagem do número de placas de circuito impresso estabelecida no item "A", caso utilize placas que sejam padrões do mercado, como por exemplo, placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm², do tipo "SIMM", do código 8473.30.00, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função.

Para o cumprimento do disposto será admitido a utilização de subconjuntos montados nas Partes Signatárias, por terceiros fabricantes, desde que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A", "B" e "C".

O disposto neste Regime, também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, de fitas, de impressoras e de leitores ópticos e/ou magnéticos e às expansões das funções mencionadas no item "A", mesmo quando não se apresentarem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.

05 - Unidades digitais de computadores de muito grande capacidade (código 8471.91.00), podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.92, com capacidade de instalação interna ou em módulos separados do gabinete do processador central de unidades de memória da subposição 8471.93, e valor FOB superior a US\$ 100.000,00, por unidade

A - Montagem e soldagem de todos os componentes no conjunto de placas de circuito impresso que implementem no mínimo duas das cinco seguintes funções: a) canal de comunicação; b) memória; c) processamento central; d) unidade de controle integrada/interface; e) suporte e diagnóstico de sistema, ou, alternativamente, a montagem de, no mínimo, 3 (três) placas de circuitos impressos que implementem quaisquer destas funções.

B - Montagem e integração das placas de circuito impresso e dos conjuntos elétricos e mecânicos na formação do produto final.

C - Quando a montagem do produto for realizada com conjuntos em forma de gavetas, estes conjuntos deverão ser montados a partir de seus subconjuntos, tais como: fonte de alimentação, placa de circuito impresso e cabos.

Quando a empresa optar pela montagem do número de placas de circuito impresso, estabelecida no item "A", caso utilize placas que sejam padrões de mercado, como por exemplo, placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm², do tipo "SIMM", do código 8473.30.00, será considerada uma placa por função, independentemente da quantidade de placas montadas para implementar a função.

Para o cumprimento do disposto será admitida a utilização de subconjuntos montados nas Partes Signatárias, por terceiros fabricantes, desde que a produção dos mesmos atenda ao estabelecido nos itens "A", "B" e "C".

O disposto neste Regime, também se aplica às unidades de controle de periféricos, tais como controladores de discos, de fitas, de impressoras e de leitores ópticos ou magnéticos e às expansões das funções mencionadas no item "A" quando não se apresentarem no mesmo corpo ou gabinete das unidades digitais de processamento.

06 - Discos rígidos (código 8471.93.00)

A -Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso.

B -Montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas em nível básico de componentes (HDA - Head Disk Assembly).

C -Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final de acordo com os itens "A" e "B" acima.

D -Será admitida a utilização de subconjuntos montados nas Partes Signatárias, por terceiros fabricantes, desde que a produção dos mesmos atenda o estabelecido nos itens "A" e "B".

E - Para a produção de discos magnéticos com capacidades de armazenamento superior a 1 GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) não formatado, poderá ser feita a opção entre cumprir o disposto nos itens "A" ou "B", sendo que no caso do cumprimento do disposto no item "A" deverão ser soldados e montados todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem pelo menos duas das seguintes funções:

I - comunicação com a unidade controladora do disco;

II - posicionamento dos conjuntos de leitura e gravação; ou

III - leitura e gravação.

07 - Circuitos impressos montados com componentes elétricos ou eletrônicos compreendidos nos seguintes códigos:

8473.29.00 - exclusivamente de caixas registradoras do código
8470.50.00

8473.30.00 - exceto placas (módulos) de memória, com uma superfície
inferior ou igual a 50cm²

8473.40.00 - todos os produtos

8517.90.00 - todos os produtos

8529.90.00 - exclusivamente de aparelhos das subposições 8525.10 e
8525.20

9032.90.00 - todos os produtos

Montagem e soldagem nas placas de circuitos impressos de todos os componentes, desde que estes não partam do código 8473.30.00.

08 - Placas (módulos de memória) com uma superfície inferior ou igual a 50 cm² (código 8473.30.00)

A - Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada.

B - Encapsulamento da pastilha.

C - teste (ensaio) elétrico.

D - Marcação (identificação) do componente (memória).

E - Montagem e soldagem dos componentes semicondutores (memória) no circuito impresso.

09 - Componentes Semicondutores e Dispositivos Optoeletrônicos dos seguintes códigos:

8541.10.00	Exceto Zener montados
8541.29.00	Exclusivamente montados
8541.30.00	Exclusivamente montados
8541.40.10	Exclusivamente células solares não montadas e fotorresistores montados
8541.40.20	Todos os produtos
8541.50.20	Exclusivamente montados
8542.11.00	Montados, exceto microprocessadores, microcontroladores, co-processadores e circuitos do tipo "chipset"
8542.19.00	Exclusivamente montados

A - Montagem da pastilha semicondutora não encapsulada.

B - Encapsulamento da pastilha montada.

C - Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico.

D - Marcação (identificação).

E - Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora.

F - Os circuitos integrados monolíticos projetados em uma das Partes Signatárias ficam dispensados de realizar as fases "A" e "B" acima.

10 - Componentes a filme espesso ou a filme fino (código 8542.20.00)

A - Processamento físico-químico sobre substrato.

B - Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico.

C - Marcação (identificação).

D - Para a produção de circuitos integrados híbridos, ficam dispensados de atender os itens "A", "B" e "C", os componentes semicondutores utilizados como insumos na produção dos mesmos.

11 - Células fotovoltaicas (código 8541.40.10), em módulos ou painéis, compreendendo exclusivamente os seguintes produtos:

--Fotodiodos

--Células solares

A -Processamento físico-químico, referente a etapas de divisão, texturização e metalização

B - Encapsulamento da pastilha montada

C - Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico

D - Marcação (identificação)

12 - Cabos de fibras ópticas dos seguintes códigos:

8544.70.00 - exceto com revestimento externo de aço, próprios para instalação submarina (cabo submarino)

9001.10.00 - exclusivamente cabos

A - Pintura de fibras.

B - Reunião de fibras em grupos.

C - Reunião para formação de núcleo

D - Extrusão da capa ou aplicação de armação metálica e marcação.

E - Será admitida a realização das atividades descritas nos itens "A" e "B", por terceiros fabricantes, desde que efetuadas em uma das Partes Signatárias.

F - As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto à sua fabricação e testes (ensaios) de aceitação operacional.

G - Os cabos ópticos deverão utilizar fibras ópticas que atendam o requisito específico de origem definido para as mesmas

13 - Exclusivamente fibras ópticas (9001.10.00)

A - Processamento físico-químico que resulte na obtenção da preforma.

B - Puxamento da fibra.

C - Testes.

D - Embalagem.

E - Será admitida a realização da atividade descrita no item "A" por terceiros fabricantes, desde que efetuada em uma das Partes Signatárias.

As empresas deverão realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptação do produto à sua fabricação e teste (ensaios).